



รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

เทคนิคการวิเคราะห์ผลผลิตด้านความบกพร่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นซิลิคอน
Defect and Yield Analysis of Electronics Devices on Silicon Wafer

นายวีระ เพ็งจันทร์

ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง